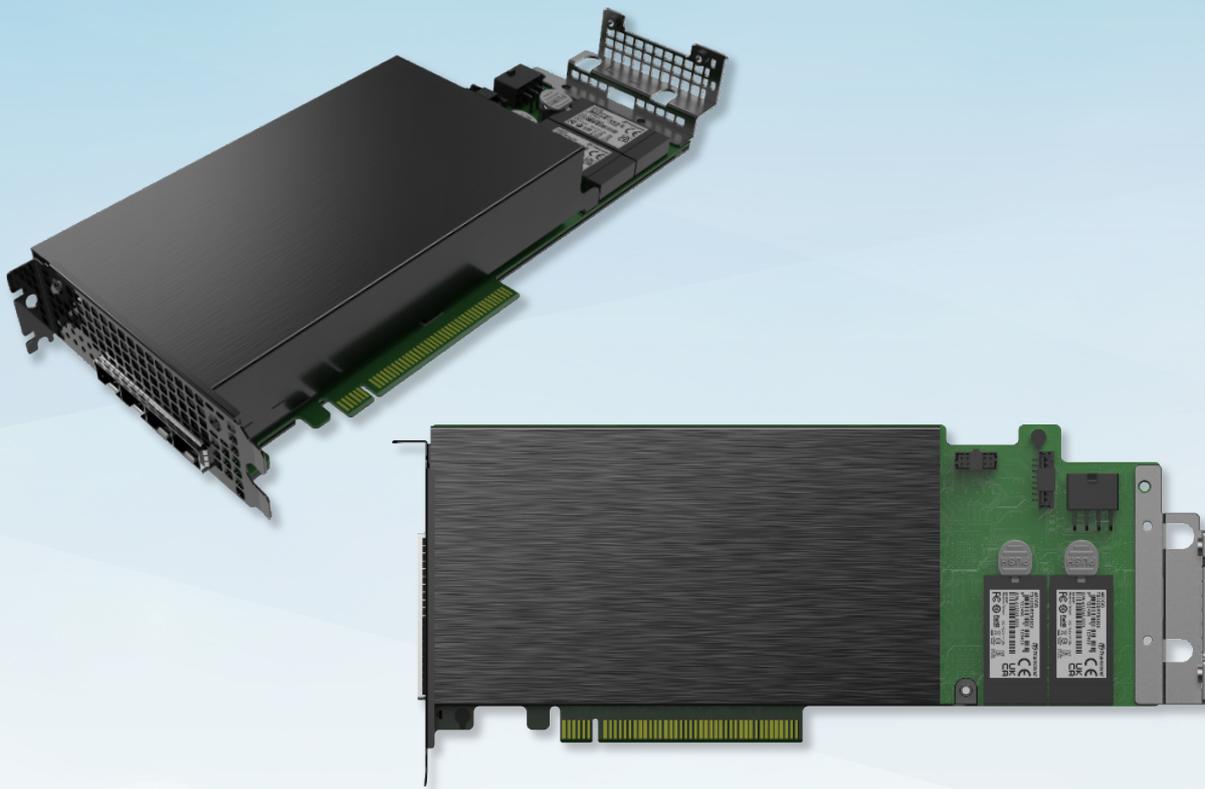


华为全自研SP900系列DPU卡



高性能

算力高

- 集成24核自研处理器芯片

性能领先

- 大数据查询性能提升40%
- 裸金属服务秒级发放*



高可靠

数据双备份

- 最多2个M.2 SSD盘，满足电信级高可靠性

硬件自监控

- 板载MCU硬件状态监控
- 硬件自检保障硬件可靠运行



易编程

编程灵活

- 开放DPAK，兼容智能网卡和DPU
- 提供北向标准生态接口，易集成

多场景加速

- 提供网络加速、存储加速、计算加速等SDK加速能力



易运维

运维高效

- 自研管理工具和带外管理功能，全量管理DPU卡

应用场景



运营商

网络云NFV、IT云等



金融

金融大数据、裸金属场景



安平

大数据



互联网

裸金属场景

*秒级发放：指的是从系统云盘挂载完毕到主机出现BIOS热键界面的时间小于60s

技术参数

功能	SP923Q
网络接口	4*25G
主机接口	PCIe4.0 x16, 兼容PCIe 3.0, 兼容x8/x4
处理器	华为海思Hi1822处理器 (24 cores)
内存	内部支持4通道DDR4-2400MT/s ECC内存, 内存容量32GB
存储	2*64GB NVMe M.2 SSD, 作为OS启动盘 双盘支持RAID 1 (出厂默认不组RAID, RAID 1需要客户基于选择的OS自行做配置)
系统管理	Huawei iBMC: 服务器BMC管理接口, 支持SNMP、IPMI, 提供GUI、硬件监控等特性
安全特性	借助华为服务器iBMC安全特性, 包括管理员密码、机箱开盖事件记录。 面板安全, 拆卸需要开箱
通用功能	<p>通用:</p> <ul style="list-style-type: none">支持IPv4/IPv6支持PF单播列表过滤、组播列表过滤、混杂模式、全组播模式支持VLAN支持BIOS下端口界面配置支持jumbo frame支持PFC支持流控风暴检测与抑制支持ETS支持LLDP协议支持环回测试支持多队列支持RSS分流支持队列个数管理支持队列深度管理支持FDIR基于流定向到指定队列支持光模块管理支持中断聚合参数配置支持中断聚合参数自适应支持速率自适应支持速率自协商支持修改MTU支持端口点灯支持端口bonding支持网口复位 <p>硬件加速:</p> <ul style="list-style-type: none">支持TSO/LRO卸载支持UDP/GSO (卸载)支持GRO/LRO卸载支持VLAN卸载支持TCP/UDP/IP Checksum卸载 <p>运维管理:</p> <ul style="list-style-type: none">支持NC-SI支持MCTP over PCIe支持带外方式获取芯片日志支持网卡管理CLI工具支持安全启动支持UEFI下PXE支持MAC层错误报文检测支持IP层错误报文检测PF支持查询光模块信息PF支持查询link失败原因PF支持异常中断恢复处理支持link失败快速上报PF支持设备PM暂停或恢复PF支持光模块管理支持固件安全升级
高级功能	裸金属: 网络和存储卸载
尺寸 (长宽高)	全高3/4长双槽位: 282.5mm × 126.4mm × 40.6 mm
工作环境	工作环境: 5° C~55° C, 8% RH~90% RH非凝结 存储环境度: -40° C~+65° C, 5% RH~95% RH非凝结
工作电压	8A@12V以上供电

如需了解华为全自研SP900系列DPU卡的更多信息, 请联系华为销售代表或业务合作伙伴

© 华为技术有限公司 2024。

保留一切权利。本资料仅供参考, 不构成任何形式的承诺



华为计算公众号